

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年9月16日(16.09.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/182554 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/29 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
H01L 23/31 (2006.01) H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/009704
- (22) 国際出願日: 2021年3月11日(11.03.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-043406 2020年3月12日(12.03.2020) JP
- (71) 出願人: リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 根本 拓(NEMOTO, Taku); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 田村 桜子(TAMURA, Sakurako); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 森下 友亮(MORISHITA, Tomotaka); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 四宮 圭亮(SHINOMIYA,

Keisuke); 〒1730001 東京都板橋区本町2 3 番 2 3 号 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

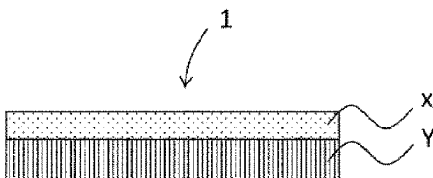
(74) 代理人: 特許業務法人大谷特許事務所 (OHTANI PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目2 5 番 2 号 虎ノ門 E ビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,

(54) Title: PROTECTIVE FILM-FORMING SHEET

(54) 発明の名称: 保護膜形成用シート



(57) Abstract: The present invention addresses the issue of providing a protective film-forming sheet that is capable of suppressing short-circuiting between narrow-pitched bumps. The issue is solved by a protective film-forming sheet that: has a laminated structure comprising a curable resin film (x) and a support sheet (Y); has a plurality of bumps; is used to form a protective film (X) on a bump-formation surface of a semiconductor wafer that fulfills a prescribed requirement that indicates the presence of narrow-pitched bumps; and fulfills a prescribed requirement specified by tensile modulus E'.

(57) 要約: 狭ピッチ化されたバンプ同士の短絡を抑制することができる、保護膜形成用シートを提供することを課題と下。そして、この課題を、硬化性樹脂フィルム(x)と、支持シート(Y)との積層構造を有する保護膜形成用シートであって、複数のバンプを有し、狭ピッチ化されたバンプを有することを示す特定の要件を満たす半導体ウエハのバンプ形成面に、保護膜(X)を形成するために用いられ、引張弾性率E'で規定される特定の要件を満たす、保護膜形成用シートとすることで解決した。

[続葉有]



WO 2021/182554 A1

ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）